

第9回 有機/無機接合研究委員会プログラム

日時：2021年3月19日(金) 9:20~12:00

形式：オンライン開催(Zoom ウェビナー)

時間	題目	講演者
司会：山口 敦史 (パナソニック(株))		
9:20~ 9:25	委員会議事	
9:25~ 9:30	休憩・準備	
9:30~ 10:10	『次世代シランカップリング剤について ～最近の研究より』 (40分)	○海野 雅史 (群馬大学)
10:10~ 10:15	休憩・準備	
司会：木村 文信 (東京大学)		
10:15~ 10:55	『樹脂モールド構造における異種材料間 の接着界面強度評価』 (40分)	○山崎 美稀 (株)日立製作所
10:55~ 11:00	休憩・準備	
11:00~ 12:00	『フレキシブルハイブリッドエレクトロ ニクスの研究開発と応用展開』 (60分)	○時任 静士 (山形大学)

() 内時間は、質疑応答時間を含む。

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。